

证券代码：688603

证券简称：天承科技

广东天承科技股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2024-003

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input checked="" type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 电话会议
参会单位	通过上证路演中心参与“天承科技 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会”的投资者
调研时间	2024 年 5 月 23 日（周四）13:00-14:00
会议地点	上证路演中心 (https://roadshow.sseinfo.com/)
上市公司接待人员姓名	董事长、总经理：童茂军 董事会秘书、副总经理：费维 财务总监：王晓花 独立董事：杨振国
投资者关系活动主要内容记录	<p>一、董事长童茂军先生致辞</p> <p>二、网络文字互动问答</p> <p>（一）公司的电镀化学品有没有用于高速连接器或其他铜缆连接组件？</p> <p>答复： 尊敬的投资者您好！公司目前在高速连接器领域正在进行相关市场状况的调研。感谢您的关注谢谢！</p> <p>（二）您好，请问公司在半导体先进封装领域目前取得了哪些突破？谢谢</p> <p>答复： 尊敬的投资者您好，公司在先进封装领域中 RDL、bumping、</p>

	<p>TSV 和 TGV 相关的电镀添加剂产品不断迭代。在种子层生成方面，公司不断探索用化学沉积的方式取代 PVD。感谢您的关注！</p> <p>(三) 请问公司最近东南亚拓展情况如何？</p> <p>答复：</p> <p>尊敬的投资者您好，公司已与下半年将在泰国、马来西亚等地区投产的部分客户进行了充分沟通，相关的前期技术支持、解决方案提供等工作在陆续进行中，公司将在前述客户开线投产时向其提供产品及配套技术服务。感谢您的关注！</p> <p>(四) 请问公司在半导体封测大会上具体推出了哪些产品？客户反馈如何？谢谢</p> <p>答复：</p> <p>尊敬的投资者您好！封测大会期间不少客户对公司的 RDL 的 SkyFab VF60, bumping 的 SkyFab CP50 产品的表现性能比较感兴趣，尤其对 TSV 的 SkyFab TSV10 和 TGV 的 SkyFab THF8 电镀填孔效果非常感兴趣，不少客户也对后期的合作进行了相关探讨。感谢您的关注，谢谢！</p> <p>(五) 请问公司在玻璃基板领域的相关产品进展如何？</p> <p>答复：</p> <p>尊敬的投资者您好，玻璃基板的 core 层对 TGV 技术要求很高，目前公司在该技术方面已取得了突破。在增层技术方面，公司的 ABF 载板湿电子化学品解决方案能完全适用。感谢您的关注！</p> <p>(六) 上海项目现在是否已开始贡献营收？按目前行业趋势和公司手订单能否对下半年经营情况进行下展望</p> <p>答复：</p> <p>尊敬的投资者您好，上海二期项目工厂已具备生产能力，即将启动试生产工作，后续等待终端客户的验证。公司先进封装相关电镀产品目前在头部封测客户等多处下游验证顺利，公司对二期项目充满信心。感谢您的关注！</p>
附件清单	无
日期	2024 年 5 月 25 日

